

2016-2022年中国LED封装产业发展态势及十三五 发展态势预测报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2016-2022年中国LED封装产业发展态势及十三五发展态势预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/diaochang/247462247462.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

LED（发光二极管）封装是指发光芯片的封装，相比集成电路封装有较大不同。LED的封装不仅要求能够保护灯芯，而且还要能够透光。所以LED的封装对封装材料有特殊的要求。

中国报告网发布的《2016-2022年中国LED封装产业发展态势及十三五发展态势预测报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 LED封装相关概述

1.1 LED封装简介

1.1.1 LED封装作用

1.1.2 LED封装的形式

1.1.3 LED封装的结构类型

1.1.4 LED封装的工艺流程

1.1.5 LED封装对封装材料要求

1.2 LED封装的常见要素

1.2.1 LED引脚成形方法

1.2.2 LED弯脚及切脚

1.2.3 LED清洗

1.2.4 LED过流保护

1.2.5 LED焊接条件

第二章 2014-2015年中国LED封装产业整体运营态势分析

2.1 2014-2015年世界LED封装业的发展总况

2.1.1 世界LED封装业发展规模及应用

2.1.2 世界LED封装企业分析

2.1.3 世界LED封装技术先进性分析

2.2 2014-2015年中国LED封装业的发展综述

2.2.1 中国LED封装业发展成果

2.2.2 产值增长情况

2.2.3 产量增长情况

2.2.4 价格分析

2.2.5 利好因素

2.3 2014-2015年国内重要LED封装项目的建设进展

2.3.1 韩企投资扬州兴建LED封装基地

2.3.2 西安经开区LED封装线项目投产

2.3.3 长治高科LED封装项目竣工投产

2.3.4 敬亭园中园LED支架及封装项目开建

2.3.5 源力光电LED封装线正式投产

2.4 SMDLED封装

2.4.1 SMDLED封装市场发展简况

2.4.2 SMDLED封装技术壁垒较高

2.4.3 SMDLED封装产能尚未过剩

2.4.4 SMDLED封装受益于芯片价格下降

2.5 2014-2015年中国LED封装业发展中存在的热点问题探讨

2.5.1 制约我国LED封装业发展的因素

2.5.2 国内LED封装企业面临的挑战

2.5.3 封装业销售额与海外企业差距明显

2.5.4 传统封装工艺成为系统成本瓶颈

2.6 促进中国LED封装业发展的策略

2.6.1 做大做强LED封装产业的对策

2.6.2 发展LED封装行业的措施建议

2.6.3 LED封装业发展需加大研发投入

2.6.4 我国LED封装业应向高端转型

第三章 2014-2015年中国LED封装市场新格局透析

3.1 2014-2015年中国LED封装市场发展态势

3.1.1 中国成中低端LED封装重要基地

3.1.2 国内LED封装企业发展不平衡

3.1.3 中国LED封装市场缺乏大型企业

3.1.4 LED产业上游厂商涉足封装市场

3.1.5 台湾LED封装产能向大陆转移

3.2 中国LED封装企业分布状况

3.2.1 2014年LED封装企业区域分布

3.2.2 2015年LED封装企业区域分布

3.3 广东省LED封装业

3.3.1 主要特点

3.3.2 重点市场

3.3.3 发展趋势

第四章 2014-2015年中国LED封装行业技术研发进展状况

4.1 中外LED封装技术的差异

4.1.1 封装生产及测试设备差异

4.1.2 LED芯片差异

4.1.3 封装辅助材料差异

4.1.4 封装设计差异

4.1.5 封装工艺差异

4.1.6 LED器件性能差异

4.2 中国LED封装技术发展概况

4.2.1 封装技术影响LED产品可靠性

4.2.2 中国LED业专利集中在封装领域

4.2.3 中国LED封装业的技术特点

4.2.4 LED封装技术水平不断提升

4.2.5 LED封装业技术研发仍需加强

4.3 LED封装关键技术介绍

4.3.1 大功率LED封装的关键技术

4.3.2 显示屏用LED封装的技术要求

4.3.3 固态照明对LED封装的技术要求

第五章 2014-2015年中国LED封装设备及封装材料的发展

5.1 LED封装设备市场分析

5.1.1 我国LED封装设备市场概况

5.1.2 LED封装设备国产化亟需加速

5.1.3 发展我国LED封装设备业的思路

5.2 LED封装材料市场分析

5.2.1 LED封装主要原材介绍

5.2.2 我国LED封装材料市场简析

5.2.3 部分关键封装原材料仍依赖进口

5.2.4 LED封装用基板材料市场走向分析

5.3 LED封装支架市场

5.3.1 国内LED封装支架市场格局分析

5.3.2 LED封装支架技术未来发展趋势

5.3.3 我国LED封装支架市场前景广阔

第六章 2014-2015年中国LED封装产业竞争新形态分析

6.1 2014-2015年中国LED封装市场竞争格局

6.1.1 中国采购影响世界封装市场格局

6.1.2 我国LED封装市场各方力量简述

6.1.3 国内LED封装市场竞争加剧

6.1.4 本土LED封装企业整合步伐加速

6.2 2014-2015年中国LED封装企业竞争力简析

6.2.1 2014年本土封装企业竞争力排名

6.2.2 2015年本土LED封装企业竞争力排名

6.3 2016-2022年中国LED封装竞争趋势预测分析

第七章 2014-2015年全球LED封装顶尖企业分析

7.1 科锐 (CREE)

7.1.1 企业概况

7.1.2 企业LED封装运营态势

7.1.3 企业发展战略分析

7.2 日亚化学 (NICHIA)

7.2.1 企业概况

7.2.2 企业LED封装运营态势

7.2.3 企业发展战略分析

7.3 飞利浦 (Philips)

7.3.1 企业概况

7.3.2 企业LED封装运营态势

7.3.3 企业发展战略分析

7.4 三星LED (SamsungLED)

7.4.1 企业概况

7.4.2 企业LED封装运营态势

7.4.3 企业发展战略分析

7.5 首尔半导体 (SSC)

7.5.1 企业概况

7.5.2 企业LED封装运营态势

7.5.3 企业发展战略分析

第八章2014-2015年中国台湾主要LED封装重点企业运营分析

8.1 亿光电子

8.1.1 企业概况

8.1.2 企业LED封装运营态势

8.1.3 企业发展战略分析

8.2 光宝集团

8.2.1 企业概况

8.2.2 企业LED封装运营态势

8.2.3 企业发展战略分析

8.3 东贝光电

8.3.1 企业概况

8.3.2 企业LED封装运营态势

8.3.3 企业发展战略分析

8.4 宏齐科技

8.4.1 企业概况

8.4.2 企业LED封装运营态势

8.4.3 企业发展战略分析

8.5 台积电

8.5.1 企业概况

8.5.2 企业LED封装运营态势

8.5.3 企业发展战略分析

8.6 艾笛森

8.6.1 企业概况

8.6.2 企业LED封装运营态势

8.6.3 企业发展战略分析

第九章2014-2015年中国内地主要LED封装重点企业

9.1 国星光电(002449)

9.1.1 企业概况

9.1.2 企业主要经济指标分析

9.1.3 企业盈利能力分析

9.1.4企业偿债能力分析

9.1.5企业运营能力分析

9.1.6企业成长能力分析

9.2 雷曼光电

9.1.1 企业概况

(一) 企业偿债能力分析

(二) 企业运营能力分析

(三) 企业盈利能力分析

9.1.2 企业LED封装运营态势

9.1.3 企业发展战略分析

9.3 鸿利光电

9.1.1 企业概况

(一) 企业偿债能力分析

(二) 企业运营能力分析

(三) 企业盈利能力分析

9.1.2 企业LED封装运营态势

9.1.3 企业发展战略分析

9.4 大族光电 (002008)

9.4.1 企业概况

9.4.2 企业主要经济指标分析

9.4.3 企业盈利能力分析

9.4.4企业偿债能力分析

9.4.5企业运营能力分析

9.4.6企业成长能力分析

9.5 深圳市瑞丰光电子有限公司

9.5.1 企业概况

9.5.2 企业主要经济指标分析

9.5.3 企业盈利能力分析

9.5.4企业偿债能力分析

9.5.5企业运营能力分析

9.5.6企业成长能力分析

9.6 宁波升谱光电半导体有限公司

9.6.1 企业概况

9.6.2 企业主要经济指标分析

9.6.3 企业盈利能力分析

9.6.4企业偿债能力分析

9.6.5企业运营能力分析

9.6.6企业成长能力分析

9.7 南京汉德森科技股份有限公司

9.7.1 企业概况

9.7.2 企业主要经济指标分析

9.7.3 企业盈利能力分析

9.7.4 企业偿债能力分析

9.7.5 企业运营能力分析

9.7.6 企业成长能力分析

第十章 2016-2022年中国LED封装发展趋势及前景

10.1 2016-2022年LED封装未来发展趋势

10.1.1 功率型白光LED封装技术发展趋势

10.1.2 LED封装技术将向模块化方向发展

10.1.3 LED封装产业未来发展走向分析

10.2 2016-2022年中国LED封装市场前景展望

10.2.1 我国LED封装市场发展前景乐观

10.2.2 LED封装产品应用市场将持续扩张

10.2.3 中国LED通用照明封装市场规模预测

第十一章 2016-2022年中国LED封装投资前景预测

11.1 2016-2022年中国LED封装投资概况

11.1.1 LED封装行业投资特性

11.1.2 LED封装具有良好的投资价值

11.1.3 LED封装投资环境利好

11.2 2016-2022年中国LED封装投资机会分析

11.2.1 LED封装投资热点（LED照明、LED照明电视）

11.2.2 国家节能减排衍生LED封装投资机会

11.3 2016-2022年中国LED封装投资风险及防范

11.3.1 技术风险分析

11.3.2 金融风险分析

11.3.3 政策风险分析

11.3.4 竞争风险

11.4 专家建议

图表目录：

图表12009-2015年台湾、大陆主要SMDLED企业产能对比

图表22015年中国大陆SMDLED主要厂商的扩产情况

图表32015年在大陆扩产的主要港台企业

图表4国星光电LED芯片单价变动对LED封装产品毛利的影响

图表52014-2015年台湾前8大LED封装厂SMD产能及大陆业务

图表62015年台湾在大陆投资的LED封装项目

图表72014年全国LED封装企业区域分布

图表82010中国LED封装企业竞争力排名

图表9近3年佛山市国星光电股份有限公司销售毛利率变化情况

图表10近3年佛山市国星光电股份有限公司资产负债率变化情况

图表11近3年佛山市国星光电股份有限公司产权比率变化情况

图表12近3年佛山市国星光电股份有限公司固定资产周转次数情况

图表13近3年佛山市国星光电股份有限公司流动资产周转次数变化情况

图表14近3年佛山市国星光电股份有限公司总资产周转次数变化情况

图表15近3年深圳雷曼光电科技股份有限公司资产负债率变化情况

图表16近3年深圳雷曼光电科技股份有限公司产权比率变化情况

图表17近3年深圳雷曼光电科技股份有限公司固定资产周转次数情况

图表18近3年深圳雷曼光电科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况

图表19近3年深圳雷曼光电科技股份有限公司总资产周转次数变化情况

图表20近3年深圳雷曼光电科技股份有限公司销售毛利率变化情况

图表21近3年广州市鸿利光电股份有限公司资产负债率变化情况

图表22近3年广州市鸿利光电股份有限公司产权比率变化情况

图表23近3年广州市鸿利光电股份有限公司固定资产周转次数情况

图表24近3年广州市鸿利光电股份有限公司流动资产周转次数变化情况

图表25近3年广州市鸿利光电股份有限公司总资产周转次数变化情况

图表26近3年广州市鸿利光电股份有限公司销售毛利率变化情况

图表27近3年深圳市大族光电设备有限公司销售毛利率变化情况

图表28近3年深圳市大族光电设备有限公司资产负债率变化情况

图表29近3年深圳市大族光电设备有限公司产权比率变化情况

图表30近3年深圳市大族光电设备有限公司固定资产周转次数情况

图表31近3年深圳市大族光电设备有限公司流动资产周转次数变化情况

图表32近3年深圳市大族光电设备有限公司总资产周转次数变化情况

图表33近3年深圳市瑞丰光电子有限公司销售毛利率变化情况

图表34近3年深圳市瑞丰光电子有限公司资产负债率变化情况

图表35近3年深圳市瑞丰光电子有限公司产权比率变化情况

图表36近3年深圳市瑞丰光电子有限公司固定资产周转次数情况

图表37近3年深圳市瑞丰光电子有限公司流动资产周转次数变化情况

图表38近3年深圳市瑞丰光电子有限公司总资产周转次数变化情况

图表39近3年宁波升谱光电半导体有限公司销售毛利率变化情况

图表40近3年宁波升谱光电半导体有限公司资产负债率变化情况

图表41近3年宁波升谱光电半导体有限公司产权比率变化情况

图表42近3年宁波升谱光电半导体有限公司固定资产周转次数情况

图表43近3年宁波升谱光电半导体有限公司流动资产周转次数变化情况

图表44近3年宁波升谱光电半导体有限公司总资产周转次数变化情况

图表45近3年南京汉德森科技股份有限公司销售毛利率变化情况

图表46近3年南京汉德森科技股份有限公司资产负债率变化情况

图表47近3年南京汉德森科技股份有限公司产权比率变化情况

图表48近3年南京汉德森科技股份有限公司固定资产周转次数情况

图表49近3年南京汉德森科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况

图表50近3年南京汉德森科技股份有限公司总资产周转次数变化情况

图表详见正文

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，有利于降低企事业单位决策风险。（GY KWW）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/diaochang/247462247462.html>